

EV Group announces next-generation EVG150 resist processing platform – November 8, 2022

EVG announced that it has strengthened its portfolio of optical lithography solutions with the unveiling of the next-generation 200-mm version of its EVG®150 automated resist processing system. The redesigned EVG150 platform includes advanced features and enhancements that provide even greater throughput (by up to 80 percent) and versatility, as well as smaller tool footprint (by nearly 50 percent), compared to the previous-generation platform. The EVG150 provides reliable and high-quality coating and developing processes in a universal platform that supports a variety of devices and applications, including advanced packaging, MEMS, RF, 3D sensing, power electronics, and photonics. Its high throughput, flexibility and repeatability support the most demanding needs for both high-volume production and industrial development.

news1 뉴스 포토 | 카드뉴스 | 그래픽뉴스

정치 | 북한 | 사회 | 경제 | IT/과학 | 금융/증권 | **산업** | 지방 | 국제 | 생활/문화

경제 | 전기전자 | 자동차산업 | 에너지 | 공공연 | 유통 | 생활경제 | 중기·창업 | 파산 | 뷰티 | 호텔·관광 | 의료 | 식음료 | 헬스케어 | IT

홈 > 산업 > 중기·창업

EV Group, 차세대 EVG150 레지스트 처리 플랫폼 출시

(서울=뉴스1) 임혜중 기자 | 2022-11-08 11:16 송고

댓글 0

공유 | 가 | 음



EV Group 제공

EV Group(EVG)은 자사의 리소그래피 솔루션 포트폴리오에 속하는 차세대 200mm 제품으로서 EVG®150 자동화 레지스트 처리 시스템을 출시한다고 8일 밝혔다. 새로운 디자인의 EVG150 플랫폼은 이전 세대 플랫폼과 비교해서 최대 80퍼센트 까지 더 높은 생산성, 우수한 범용성, 50퍼센트 더 작은 풋프린트가 특징이다.

11월 15일부터 18일까지 나흘간 독일 뮌헨의 메세 뮌헨에서 개최되는 세미콘 유로파(SEMICON Europa) 전시회에서 EVG 부스를 방문하면 EVG의 임직원들로부터 직접 차세대 EVG150 레지스트 처리 시스템에 관한 설명을 들을 수 있다.

EBS(electronic based system) 연구 센터인 실리콘 오스트리아 랍스(Silicon Austria Labs)는 차세대 EVG150 시스템의 첫 번째 고객이다.

200mm 기반용 차세대 EVG150은 이전 세대 플랫폼의 업계 선도적인 특성을 그대로 유지하고 있다. 회전 및 분사 코팅, 현상, 베이킹 및 냉각 공정을 위해 맞춤형 모듈 구성이 가능한 완벽하게 자동화된 플랫폼이다.

복잡한 형태의 컨포멀 코팅이 가능한 EVG 고유의 OmniSpray® 기술, 지속적으로 높은 생산성을 달성하도록 듀얼 엔드 이펙터 기능을 사용하는 정교하고 성능이 검증된 로봇 핸들링, 그리고 웨이퍼 예지 핸들링과 휘거나 뒤틀린 웨이퍼, 또는 박막 웨이퍼를 취급할 수 있는 능력이 포함된다.

차세대 EVG150 200mm 플랫폼은 최대 4개의 습식 처리 모듈 공간과 최대 20개의 베이킹/냉각 유닛을 제공하므로, 여러 웨이퍼를 동시에 처리 가능, 코팅 챔버들을 분리시킴으로써 모듈들을 완벽하게 격리할 수 있다. 모듈 간의 교차 오염을 실질적으로 제거, 디자인을 개선해서 장비 바깥에서 개별 챔버에 용이하게 접근할 수 있으므로 챔버 유지보수 작업 시 가동 중단 시간을 최소화한다.

계속해서 장비 가동 가능, 챔버들의 위치를 변경해서 로봇 핸들링 유닛에 용이하게 접근할 수 있으므로 수월하게 유지보수가 가능하고 이미지 기반의 프리알라이너(pre-aligner)를 사용한 신속 웨이퍼 센터링으로 처리 시간을 단축할 수 있다. 시스템 내에 레지스트 및 화학물질 라인을 통합함으로써 화학물질 저장을 위한 외부 캐비닛 공간 절약 및 장비 풋프린트 축소, 시스템 내에 사용자 인터페이스를 통합하여 장비 풋프린트를 더욱 축소 등의 특징을 가진다.

EVG의 기업 테크놀로지 디렉터인 토마스 글린스너(Thomas Glinsner) 박사는 "레지스트와 패터닝 공정은 반도체 제조에 있어서 가장 반복적으로 사용되는 공정들이다. EVG는 리소그래피와 회전 및 분사 코팅 등의 공정 분야에서 다년간 쌓아온 전문성을 바탕으로 고객들의 극히 까다로운 요구를 충족하는 솔루션을 제공한다"며 "차세대 EVG150 시스템은 이러한 경험을 토대로 탄생한 것으로서, 범용 플랫폼으로 새로운 자원의 생산성과 비용 상의 이점을 달성하도록 설계되었으며 전례 없이 뛰어난 유연성으로 다양한 애플리케이션의 레지스트 공정 요구를 충족한다"고 말했다.

차세대 EVG150 자동화 레지스트 처리 시스템은 현재 장비 주문이 가능하며, EVG 본사에서 제품 데모를 진행 중이다.

<https://www.news1.kr/articles/4857482>